DAQ 板制作

杨

SiPM、元器件等

王、张

2018.12

2019.1-2019.7

支撑结构

王

方案讨论

支撑结构加工

董：董明义
胡：胡　涛
刘：刘建北
沈：沈仲弢
王：王志刚
杨：杨俊峰
张：张云龙

DIF 板制作

沈

与CALICE讨论接口协议

董、王

闪烁体

闪烁体方案确定

闪烁体批量采购/生产

LED驱动电路测试

沈

温度测试电路验证

沈

2018.10

沈、张

2018.11-2018.12

2019.1

2019.2

2019.3

2E单芯片板焊接、调试

2E单芯片板调试完毕（包括探测器）

2E芯片单层板绘制

2E芯片单层板加工、焊接

2E芯片单层板调试（2块板）

2019.4

2019.5

2019.6-2019.7

2019.8-2019.12

单层板样机制作（2块板）

单层板样机宇宙线测试（2块板）

张、王、董

机动时间（电子学板优化）

30层电子学板批量焊接、性能测试

与CALICE初步讨论束流测试数据格式

熟悉CALICE的分析软件及分析流程

样机宇宙线/束流分析程序包准备

胡、刘

2019.10

2019.11

2019.12

束流测试申请，明确束流测试各项工作责任人（IHEP、DESY两次测试）

DESY束流申请

束流测试内容讨论（IHEP、DESY）

束流测试模拟

2020.1-2020.8

2020.6

2020.11-2021.4

王、董、张、沈、杨

SiPM LED 刻度 SPIROC 噪声、线性及高低增益刻度

高能所束流测试（部分样机）

王、董、张、沈、杨

王、董、张、沈、杨

各通道参数刻度（电子学、探测器）

王、董、张、沈

2020.9

2020.10

2021.5-2021.6

在高能所进行30层样机组装、测试及分析

灵敏单元MIPs能谱、稳定性刻度

DESY束流测试准备

DESY束流测试

分析数据

能量重建（线性和能量分辨率）

撰写结题报告

各层相对位置刻度（alignment）、径迹重建

径迹重建（各层簇射中心位置重建精度）

宇宙线测试分析软件包开发

束流测试分析软件包准备